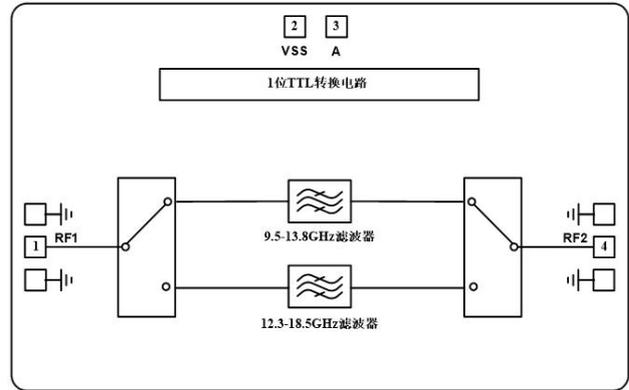




**主要特点**

- 通道数目: 2
- 通带频率: 9.5 – 13.8 GHz  
12.3 – 18.5 GHz
- 插入损耗: 5 dB
- 带内平坦度:  $\pm 0.5$  dB
- 控制电压: 0 / +3.3 V
- 供电: -5 V @ 1 mA
- 芯片尺寸:  $2 \times 1.5 \times 0.1$  mm<sup>3</sup>

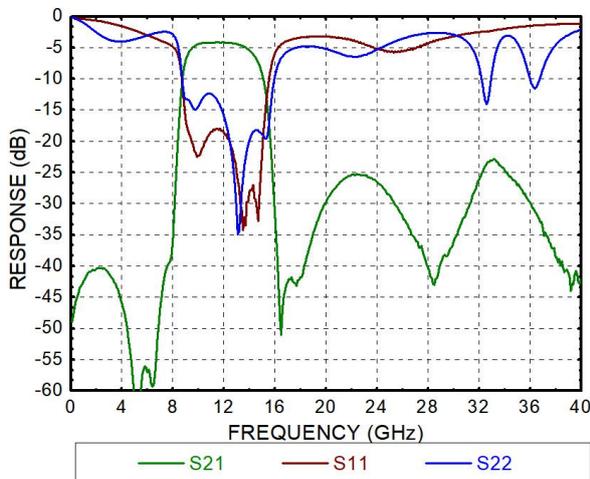
**功能框图**



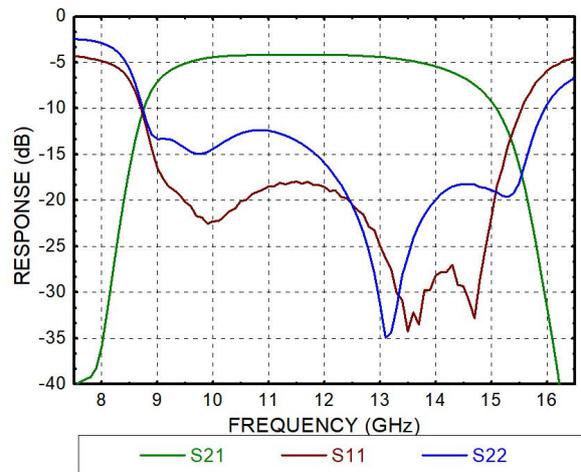
**性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{EE} = -5\text{V}$ )**

参数	9.5-13.8GHz	12.3-18.5GHz	单位
插入损耗	5	5	dB
带内平坦度	$\pm 0.5$	$\pm 0.5$	dB
回波损耗	-15	-15	dB
带外抑制	30@8GHz 30@16GHz	30@10.6GHz 30@21.2GHz	dB

**9.5-13.8GHz反射系数**

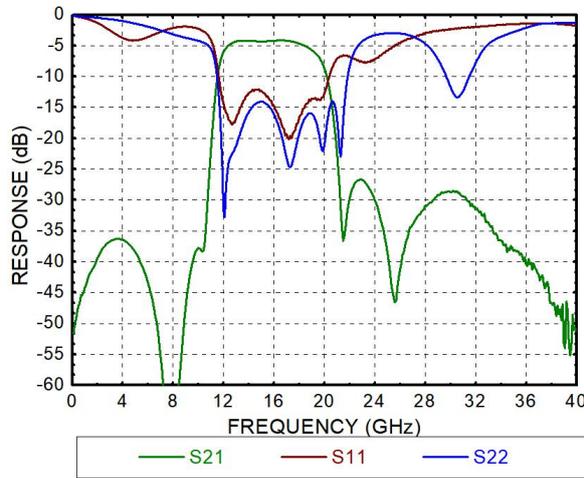


**9.5-13.8GHz反射系数**

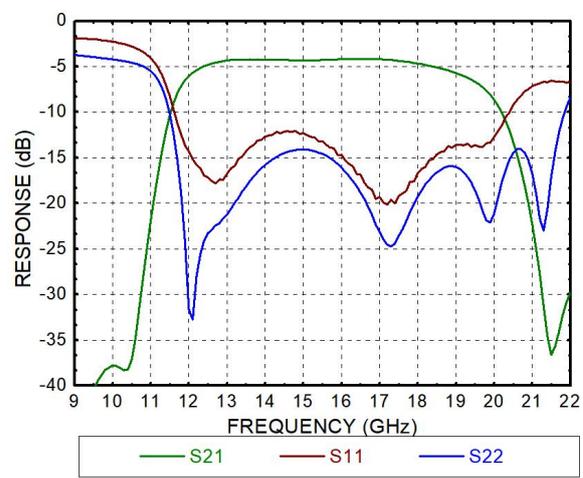




12. 3-18.5GHz反射系数

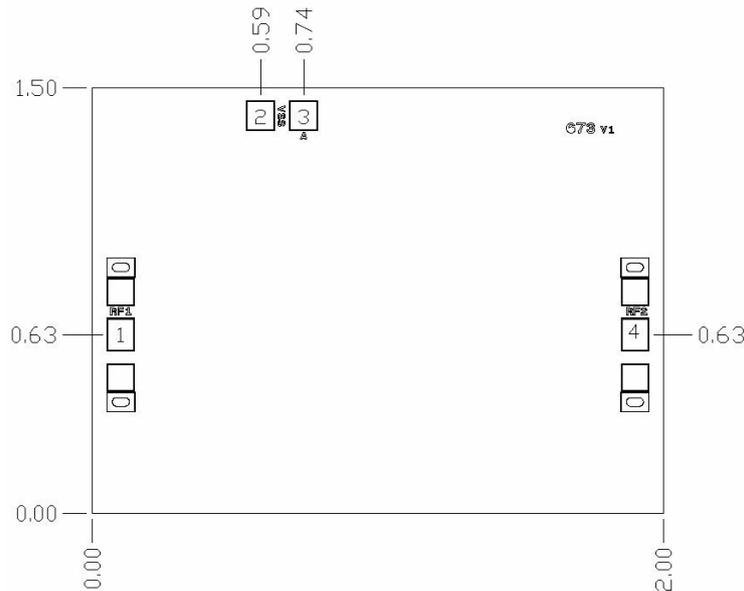


12. 3-18.5GHz反射系数



物理参数

单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1、4	RF1, RF2	该焊盘是 RF 信号输入输出端, DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
2	VSS	该焊盘是直流电源输入端, 使用时接-5V 电压
3	A	该系列焊盘为 TTL 控制电压输入端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

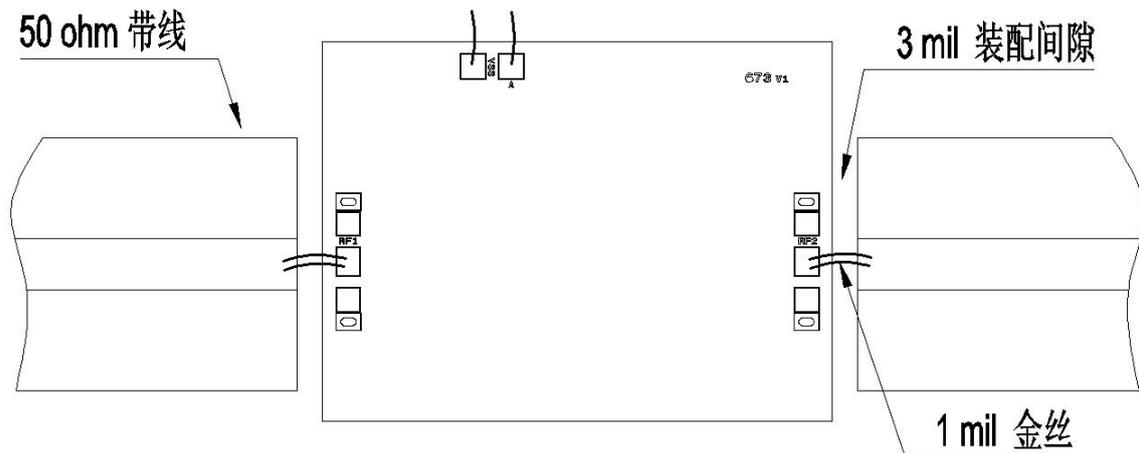


4

控制关系

控制频带	A
9.5 - 13.8 GHz	0
12.3 – 18.5 GHz	1
“0” 电平范围: 0~0.5V; “1” 电平范围: 2.3~5V	

装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
2. 典型键合焊盘尺寸为 100\*100  $\mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压: -6 V
2. 射频输入功率: +27 dBm
3. 储存温度: -65 ~ +150  $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度: -55 ~ +85  $^{\circ}\text{C}$